

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2024年5月23日-5月24日)

证券代码：东芯股份

证券简称：688110

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会） |
| 参与单位名称 | UBS Asset Management-Singapore、JP Morgan、Point72 Asset Management Lp、Franklin Templeton、Exoduspoint Capital Management Hong Kong, Limited、天弘基金、光大证券 |
| 活动时间 | 2024年5月23日、5月24日 |
| 活动地点 | 策略会、线上交流 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈幪 投资者关系：王佳颖 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、公司近期经营情况介绍</p> <p>公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司近期的经营情况。</p> <p>二、交流的主要问题及答复</p> <p>1、公司对于 DRAM 产品是如何规划的？答：DRAM 产品方面，公司将不断丰富 DRAM 产品组合，提高产品市场竞争力。2、公司对于砺算的拟投资计划目前是什么进展？答：标的公司是一家致力于研发多层次（可扩展）图形渲染的芯片设计企业。公司与标的公司的业务具有一定的协同性，本次投资有利于公司拓展新的应用场景，提升公司的市场空间，增强公司的市场竞争力和可持续发展能力，有助于进一步提高上市公司资产质量，符合公司发展战略，对公司发展具有积极影响。本次对外投资事项尚处于筹划阶段，尚未正式签署投资协议和意向性协议，最终的投资金额和股权比例尚未确定，具体的投资方案仍需进一步研究论证和沟通协商。公司后续将根据对外投资事项进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，及时履行相关审批决策程序和信息披露义务。3、公司的库存方面是怎样的趋势？答：受到存储周期的影响，公司</p> |

| | |
|----|--|
| | <p>目前的存货仍处在相对较高的水平。以未来发展的角度来看，现有库存状况基本可控。从存货结构上来看，公司大部分产品是通用型产品，存货中原材料占比更高，半成品和产成品占比相对较低，因此从结构上看也基本可控。</p> <p>4、MCP 产品主要有哪些应用？答：公司的 NAND MCP 产品集成了自主研发的低功耗 1.8V SLC NAND Flash 闪存芯片与低功耗设计的 DRAM，凭借设计优势已在紫光展锐、高通、联发科等平台通过认证，被广泛应用于功能手机、MIFI、通讯模块等产品。公司的 NAND MCP 在提供高可靠性，大容量存储的同时，可以保证客户的长期供应，客户在使用 NAND MCP 产品时可以减小 PCB 的布板空间，降低整体系统成本，提高整体集成度和可靠性，适用于 PCB 布板空间狭小的应用。</p> <p>5、对于存储周期的变化公司如何看待？答：周期性是半导体行业的常态，存储芯片行业作为强周期的行业，行业低谷不会长期持续。随着大数据时代的向前推进，数据密集型应用技术不断涌现，将引发数据存储的浪潮。随着未来市场景气度的回升和需求的逐渐恢复，以及国产替代的巨大需求，整体行业也会逐步回暖。</p> |
| 日期 | 2024 年 5 月 27 日 |